

# LED設備通訊協定成果發表會

## 光電及半導體設備產業發展計畫

- 日期：2016年10月20日
- 時間：14:00 — 17:00 (14:00-14:20 報到)
- 地點：南港展覽館 4樓 402C 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號)
- 主辦單位：IDB 經濟部工業局
- 執行單位：MIRDC 財團法人金屬工業研究發展中心、  
semi-SEMI 國際半導體產業協會
- 協辦單位：OSEG 光電及半導體設備產業推動辦公室

Agenda		
時間	議程	演講者
14:00~14:20	報到	
14:20~14:25	開場致詞 (金屬中心)	
14:25~14:55	LED 設備通訊協定成果說明	工作小組 - 陳繼賓
14:55~15:00	LED 設備通訊協定成果發表儀式 (長官貴賓合照, 全體大合照)	
15:00~15:20	LED 設備自動化應用現況與未來趨勢	晶電 - 施韋協理
15:20~15:40	設備建置 CIM 連線功能經驗分享	和椿 - 詹方興協理
15:40~16:00	工廠導入 SECS/GEM 標準 - 系統商經驗分享	飛迅特 - 周秦經理
16:00~16:20	具網實整合之微影製程曝光系統	金屬中心 - 張光寒
16:20~16:30	106 年政府資源 - 光電及半導體設備產業計畫	光電及半導體設備產業推動辦公室
16:30~17:00	Q&A 交流時間	
賦歸		